株式会社ブイ・テクノロジー

2026 年 3 月　決算説明会

2026 年 5 月 13 日

イベント概要

[企業名]	株式会社ブイ・テクノロジー
[企業 ID]	7717
[イベント言語]	JPN
[イベント種類]	決算説明会
[イベント名]	2026 年 3 月　決算説明会
[決算期]	2026 年度　第 4 四半期
[日程]	2026 年 5 月 13 日
[ページ数]	31
[時間]	13:00 – 14:00 （合計：60 分、登壇：27 分、質疑応答：33 分）
[開催場所]	インターネット配信
[会場面積]	
[出席人数]	
[登壇者]	3 名

代表取締役 社長執行役員	杉本　重人（以下、杉本）
取締役 専務執行役員	神澤　幸宏（以下、神澤）
IR 室室長	小野　雅弘（以下、小野）

[アナリスト名]*	ジェフリーズ証券	中名生　正弘
	みずほ証券	斉田　健一
	フィリップ証券	和泉　美治

*質疑応答の中で発言をしたアナリスト、または質問が代読されたアナリストの中で、SCRIPTS Asia が特定出来たものに限る

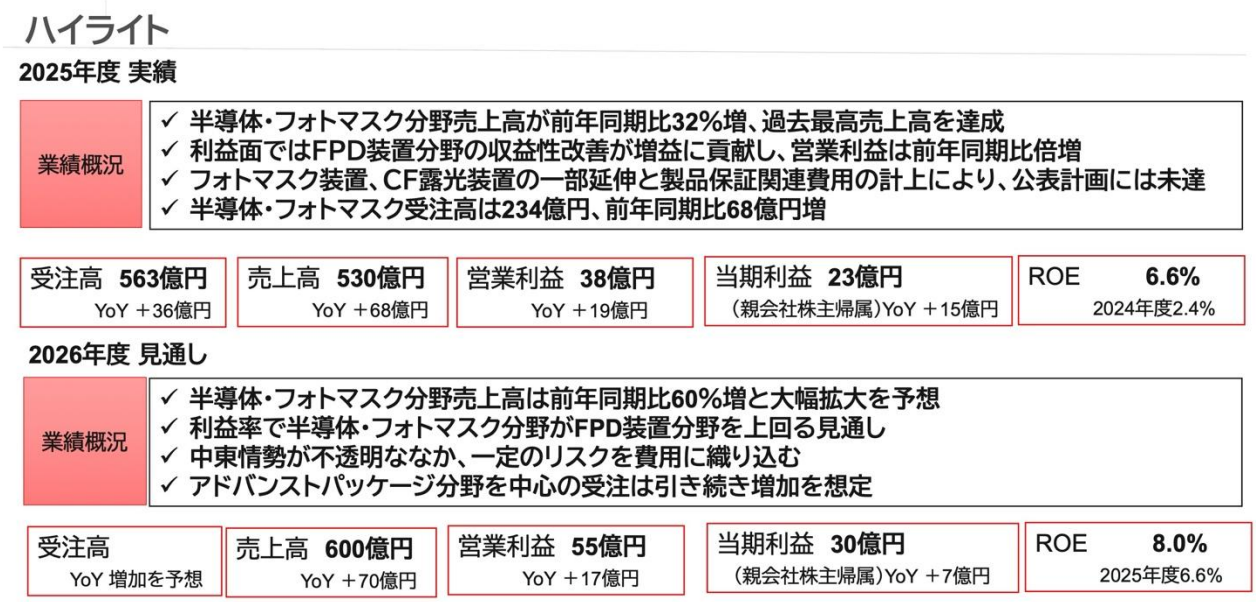
登壇

小野：ただいまより、株式会社ブイ・テクノロジー2026 年 3 月期決算説明会を開催させていただきます。

最初に、本日の出席者をご紹介します。代表取締役社長執行役員の杉本、取締役専務執行役員の神澤です。本日司会を務めますのは、IR 室の小野です。よろしくお願いいたします。

本日の進行について簡単にご案内します。まず、決算について専務の神澤よりご報告します。その後、社長の杉本より成長戦略についてお話しします。そして、プレゼンテーションが終わりました後に、皆様のご質問をお受けしたいと思っています。

それでは、神澤専務、よろしくお願いします。



神澤：神澤です。平素は大変お世話になっております。私からは、話がありました通り、決算の説明をさせていただきます。成長戦略に関しては、後ほど杉本社長からお話しします。

まず、決算のハイライトです。2025 年度、売上高は 530 億円と、前年同期比 68 億円の増加となりました。特に、半導体・フォトマスク分野の売上高が前年同期比 32%増と、過去最高を達成しました。

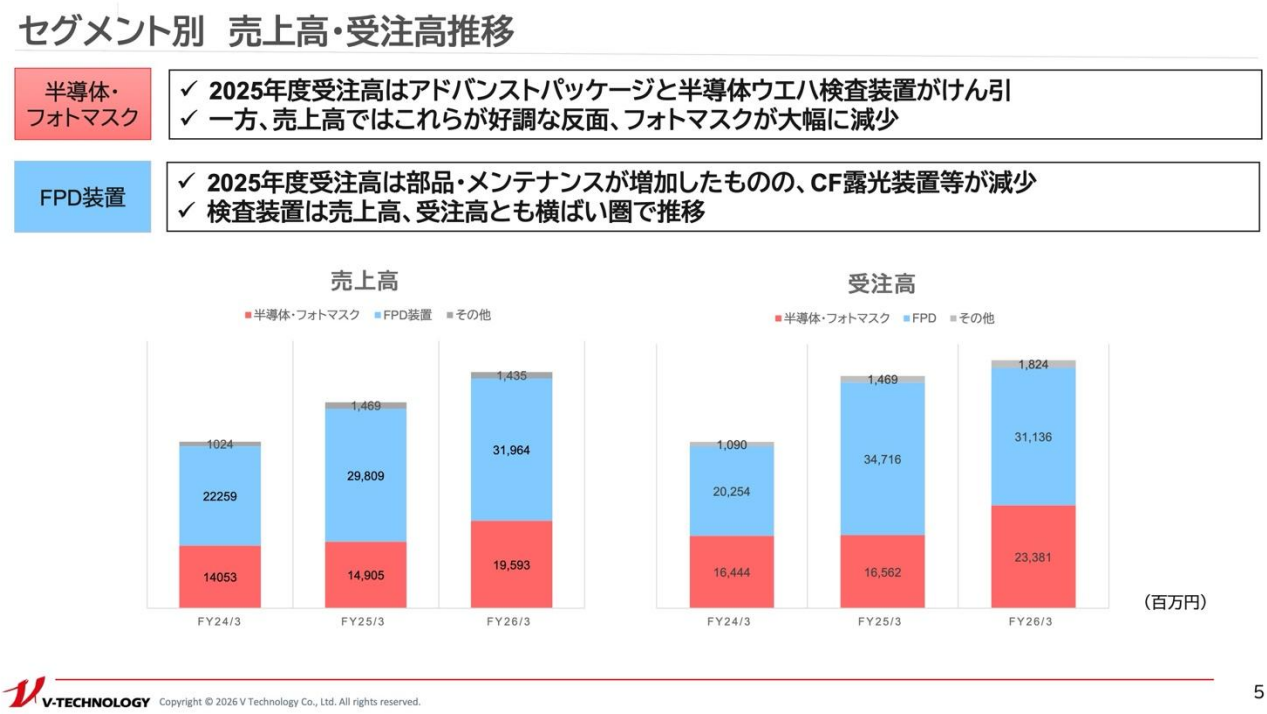
営業利益は 38 億円と、前年同期比倍となりました。特に FPD 装置の収益改善が寄与しました。

2025 年度の受注高は 563 億円、36 億円の増加となりました。特に、半導体・フォトマスク受注高は 234 億円で 68 億円増加しました。

一方、既に 4 月 30 日にリリースした通り、フォトマスク装置やカラーフィルター露光装置などの一部の延伸や、製品保証関連費用の計上などにより、残念ながら会社計画を達成することはできませんでした。

続いて、2026 年度の見通しについてです。今年度は中期計画の 3 年目になりますが、当初の計画を引き下げ、売上高は 600 億円、前年同期比 70 億の増加、営業利益は 55 億円、17 億円の増加を予想しています。いずれも、半導体・フォトマスクセグメントが増収増益のけん引役となる見込みになっています。

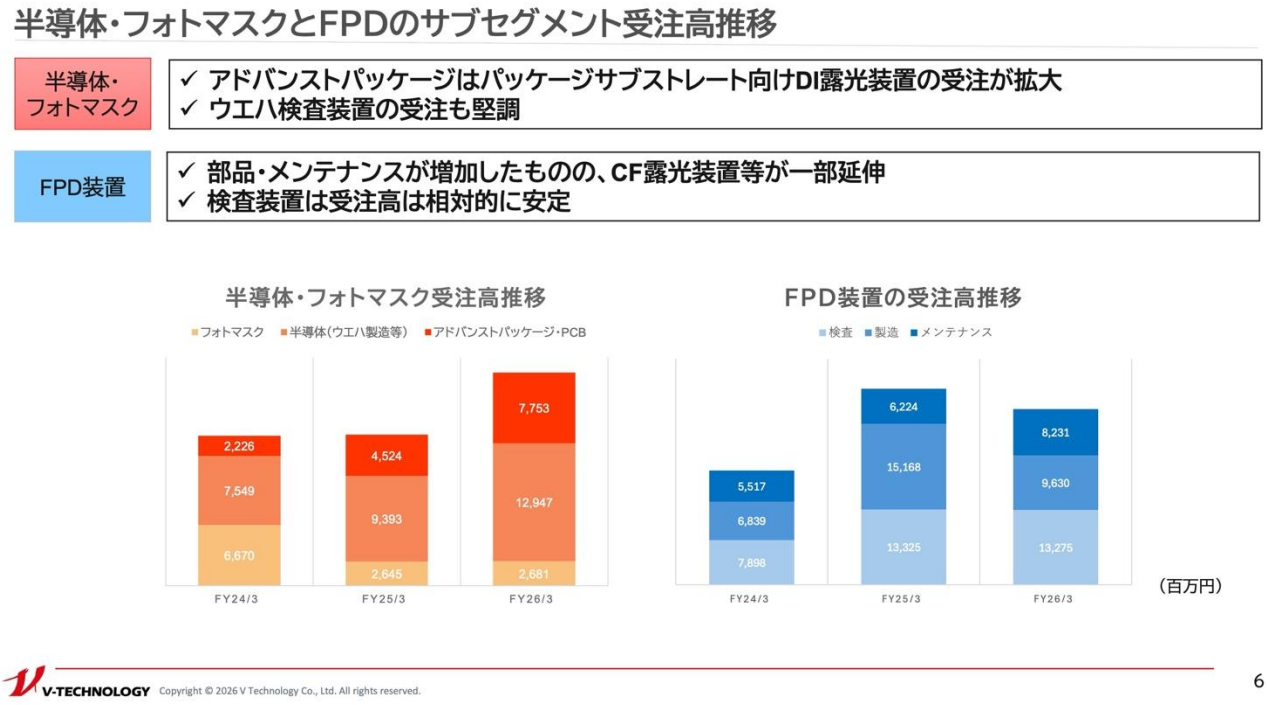
また、前回は 2026 年 3 月末受注残の計画を公表していましたが、これは中期計画の売上目標を開示していたためで、今回は 2027 年度の売上目標を開示はしていませんので、受注残の計画については公表していません。ただ、半導体・フォトマスク分野のけん引により相当額の増を見込んではいます。



続いて、2025 年度までの過去 3 年間のセグメント別の売上高と受注高の推移です。半導体・フォトマスクは、アドバンストパッケージとウェハの検査装置がけん引し、受注高・売上高ともに増加

傾向にあります。仮に、フォトマスクの減少がなければ、より大きな増収になっていた格好になっています。

一方、FPD 装置については、24 年度に大きく増えたものの、25 年度は受注が減少しました。



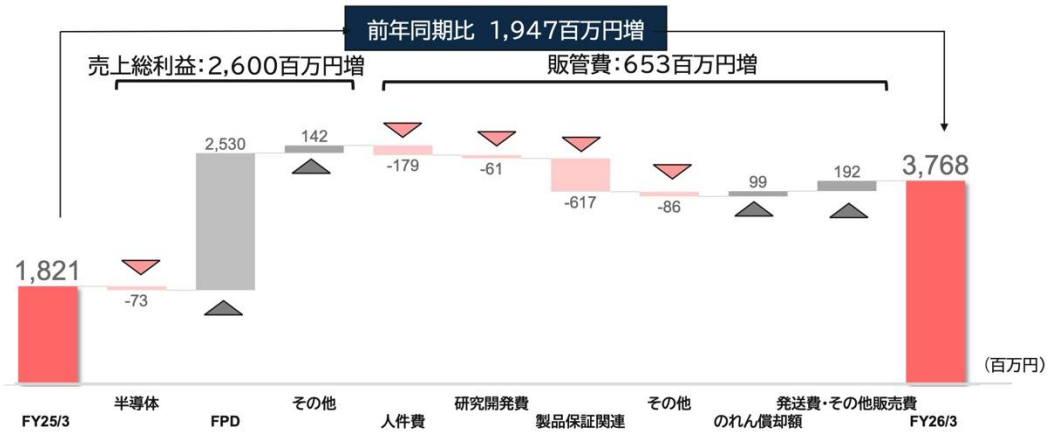
過去 3 年の受注高をサブセグメントごとに見ていきたいと思います。

半導体・フォトマスクの受注高では、ウェハの検査装置、それからアドバンストパッケージが大きく拡大している一方で、フォトマスクは 24 年度に大きく減少し、25 年度も回復を見ていません。中国向けが低調で、26 年度には一定の回復を見ています。

FPD 装置については、カラーフィルターの露光装置などの露光装置が 25 年度に大幅に減少しました。こちらも一部延伸が中国向けに発生したためです。

営業利益増減要因

✓ 半導体・フォトマスクセグメントは大幅増収ながら、フォトマスクの急減、粗利率の低い商社型ビジネスの売上拡大などにより売上総利益の増加に至らなかった
✓ 製品保証関連費用は①中国国産化が進むFPD装置②フォトマスク③ウェハ検査装置等において増加



V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

営業利益の増減要因についてご説明します。半導体・フォトマスクセグメントは、フォトマスクの売上急減や、粗利率の低いテスターの案件、そして中国製の DI 装置に関する商社型のビジネスなどでまとまった売上計上がありました。その関係で、売上総利益は前年同期並みとなりました。

一方で、FPD 装置は、高採算案件が増えたことが増益に貢献しました。販管費では、半導体・フォトマスクセグメントで製品保証関連費用が増加しました。

結果として、半導体・フォトマスクセグメントは、増収ながら営業利益では減益を余儀なくされてしまいました。

しかし、26 年度は売上総利益・営業利益ともに大幅な回復を予想しています。ここで大幅な回復について補足したいと思うのですが、まず LET の DI 露光装置が伸びてくるというのがあります。

そして、前期不調であったフォトマスク事業の改善については、レガシー半導体向けの検査装置について、やめるわけではないのですが、注力の度合いを少し弱め、主にマスクライターのほうにかじを切る、マスクライターの受注を取り、その周辺装置も取り込んでいく形で、回復を今見込んでいます。

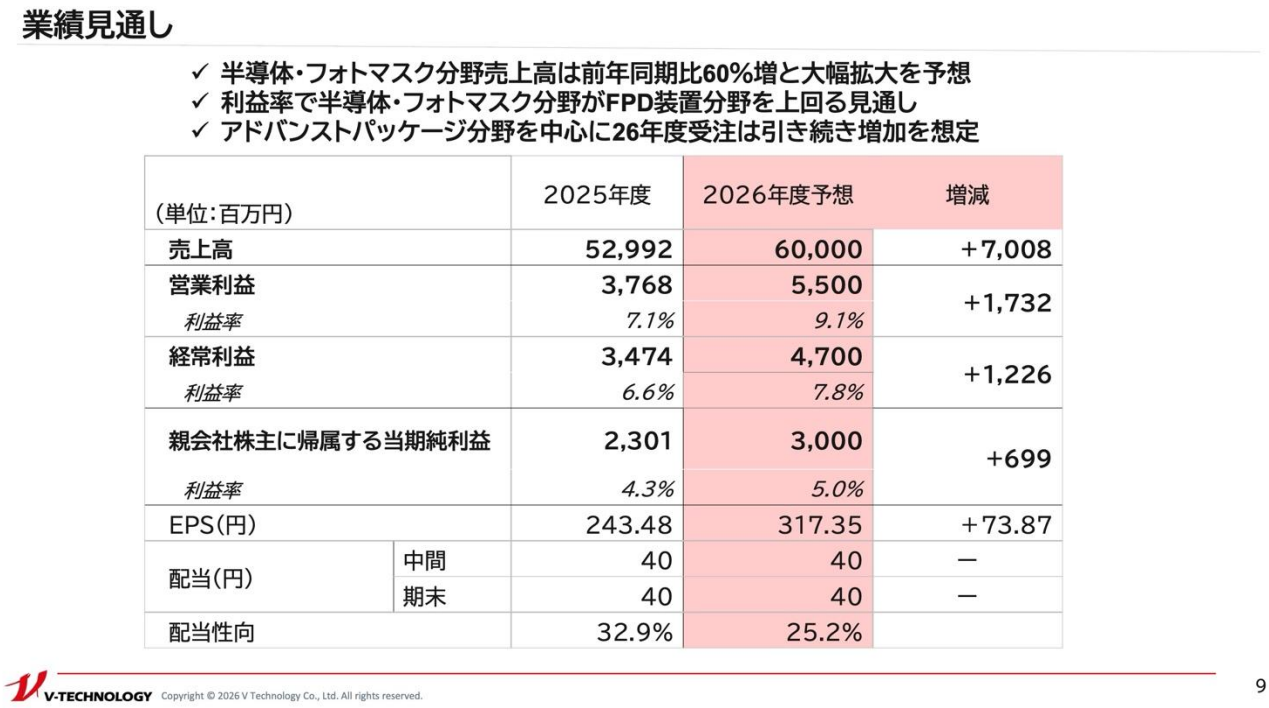
それから、マイクロプローブについても、前期売上がなかったのですが、今期については相応の売上を今見込んでいます。そして、これは非常に利益率の高い事業ですので、利益面にも貢献が見込まれています。

SCRIPTS Asia's Meetings, Globally

それから、半導体のウェハの洗浄装置、それからレジストの解析装置を扱っている子会社の業績が25 年度はあまりよくなかったのですが、ここについても回復が見込まれています。

それから、オー・エイチ・ティーの今新しいビジネスが生まれようとしていますが、ここについても非常に期待しています。

ということで、半導体・フォトマスクセグメントについては、前期に比べるとかなり改善される見込みになっていることを補足させていただきました。



業績見通し

- ✓ 半導体・フォトマスク分野売上高は前年同期比60%増と大幅拡大を予想
- ✓ 利益率で半導体・フォトマスク分野がFPD装置分野を上回る見通し
- ✓ アドバンストパッケージ分野を中心に26年度受注は引き続き増加を想定

(単位:百万円)		2025年度	2026年度予想	増減
売上高		52,992	60,000	+7,008
営業利益		3,768	5,500	+1,732
利益率		*7.1%*	*9.1%*	
経常利益		3,474	4,700	+1,226
利益率		*6.6%*	*7.8%*	
親会社株主に帰属する当期純利益		2,301	3,000	+699
利益率		*4.3%*	*5.0%*	
EPS(円)		243.48	317.35	+73.87
配当(円)	中間	40	40	ー
	期末	40	40	ー
配当性向		32.9%	25.2%	

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

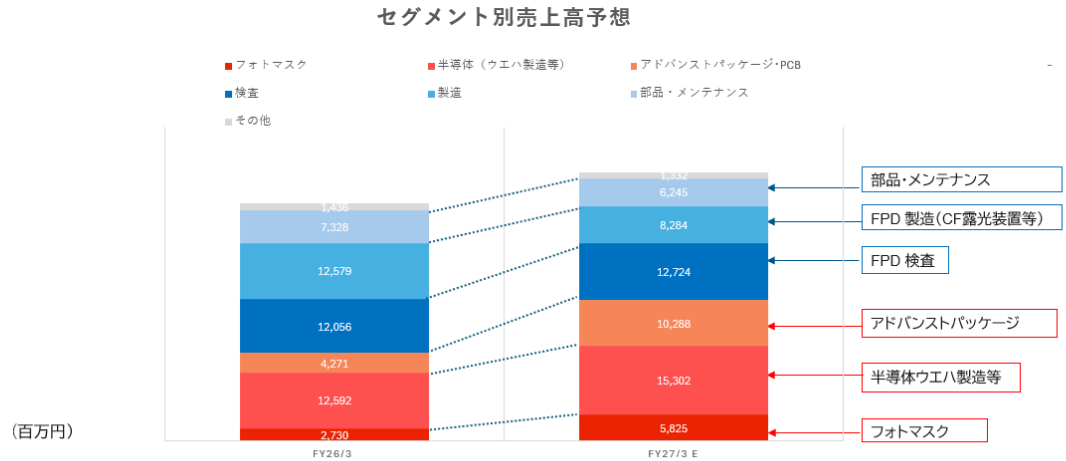
続いて、2026 年度の業績見通しについてご説明します。売上高は、25 年度に対して 70 億円増加の 600 億円、営業利益は 17 億円増加の 55 億円、売上高・営業利益率は 9%を想定しています。親会社株主に帰属する当期純利益は 30 億円の見込みです。

中期計画では、売上高 660 億円、営業利益 74 億円を設定していましたが、25 年度末の部品メンテナンスを除いた装置の受注高が 460 億円には届かなかったこと、イラン情勢の地政学リスクなどを一定額織り込んだことから、計画を変更しました。

半導体・フォトマスクセグメントの売上高は、前年同期比プラスの 60%と大幅に拡大する見通しです。同分野は、利益率でも FPD セグメントを上回る見通しになっています。受注高や受注残高の計画数字を開示していませんが、順調な増加を見込んでいます。

セグメント別売上高予想

✓半導体・フォトマスク分野では、アドバンストパッケージでDI露光機の本格拡大が寄与する見通し
✓フォトマスクは25年度の低水準から復調を見込む
✓FPD装置ではCF露光装置の減少が見込まれるものの、検査装置は堅調を予想

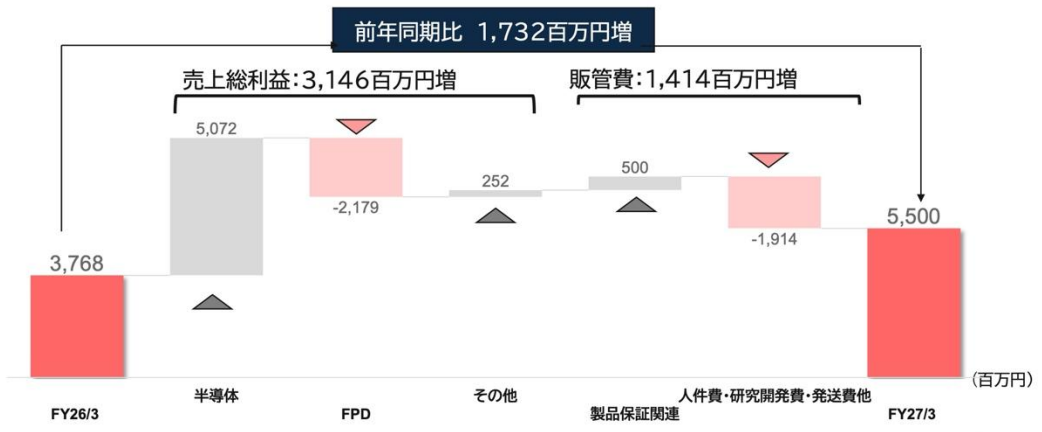


V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

セグメント別の 26 年度の売上高予想を示しました。FPD 装置のセグメントでカラーフィルター露光装置などの減少を予想するものの、半導体・フォトマスクセグメントでアドバンストパッケージ、そして半導体ウェハ製造等が拡大する見通しです。

営業利益見通し

✓ 半導体・フォトマスクセグメントでの大幅増収を予想
✓ 製品保証関連費用は減少を見込む一方、足元の地政学情勢を踏まえた輸送コスト上昇などを織り込み、販管費は増加



V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

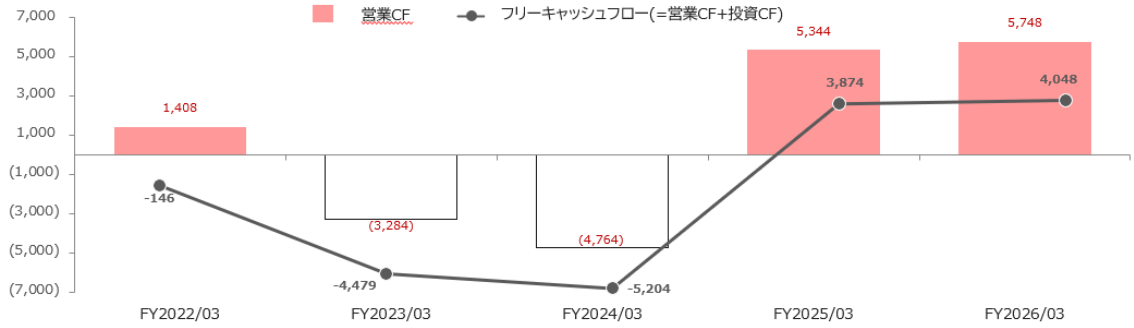
SCRIPTS Asia's Meetings, Globally

利益面では、半導体・フォトマスクセグメントの売上総利益が大きく改善する見通しです。FPD装置に比べて高い売上総利益率が可能と申し上げてきましたが、26 年度にようやく実現する見通しで、さらに利益率改善の余地があると期待しています。

また、販管費では、25 年度の利益圧迫要因となった製品保証関連費用が減少する一方で、イラン情勢で不透明感があることから、物流コストなどのリスクを一定額織り込んでいます。

営業キャッシュフローの改善に注力

✓ **25年度営業キャッシュフローは改善したが、アドバンストパッケージの設置がラッシュの26年度は減少する見通し**
✓ **装置リードタイム短縮を含めた仕掛品回転月数の短期化等を推進し改善に注力する**



（百万円）

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

続いて、キャッシュフローについてお話しします。継続的な成長実現のためには、営業キャッシュフローは極めて重要な業績評価指標であると考えています。

弊社は従来、装置の受注から設置までのリードタイム、仕掛品在庫の回転期間が長いこと、売掛債権の回収期間も長いことが問題であると課題視しており、その改善の努力を続けてまいりました。

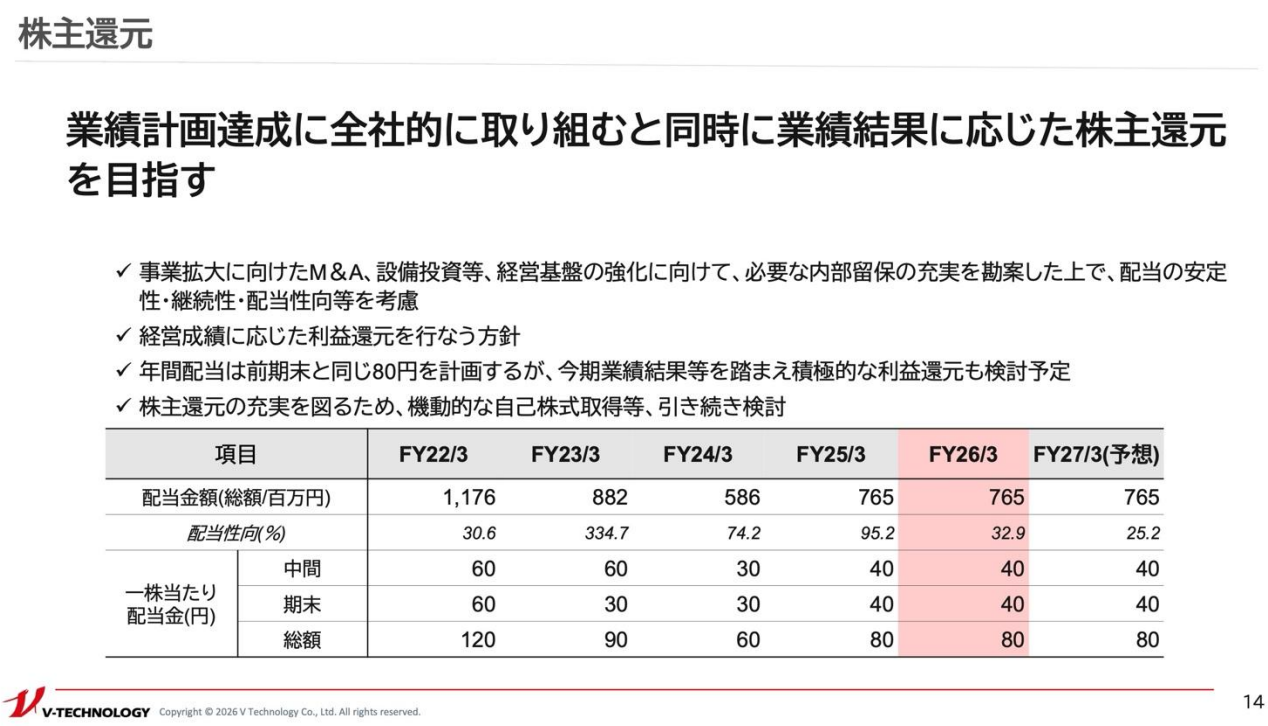
25 年度は営業キャッシュフローが 57 億円となり、一定の成果を見ることができたのではないかと思っています。

しかしながら一方で、26 年度はアドバンストパッケージの顧客生産ラインの設置が急速に増えることから、売掛の回収条件も厳しくなることが想定されています。

ですので、例えばですが、海外向けの案件、ビジネススキームを工夫し、海外向けの案件を取りにいってキャッシュフローを改善させる、あるいは先ほど言いましたリードタイムのさらなる短縮、それから見込み生産の圧縮、そういった管理を徹底させること。

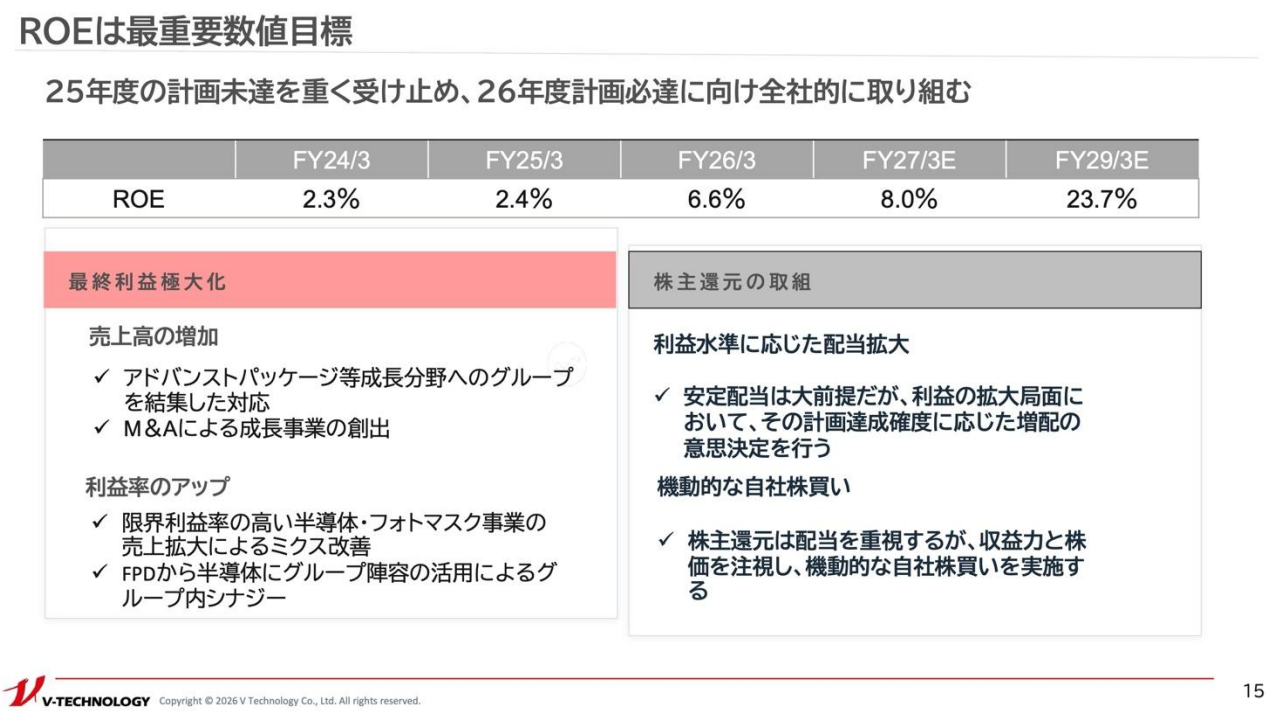
そして、グループ各社に対して、P/L だけではなくてキャッシュフロー、特に営業キャッシュフローの目標の設定、そして予実管理、こういったものもやっていきたいと思っています。

その結果として、25 年度と同レベルの営業キャッシュフロー、あるいはそれ以上の営業キャッシュフローを達成したい、それを目指したいと考えています。



また、株主還元については、今回、2026 年度の年間配当計画を 80 円と据え置いていますが、利益に対する還元の水準については常に意識しており、業績計画の達成度合いに応じた配当の決定をしていきたいと考えています。

自社株買いについても、M&A を含め、投資案件とのバランスを考慮し、機動的に対応したいと思っています。



私からは、最後に最重要指標である ROE についての進捗をご報告します。28 年度の中期経営計画の最終年度に ROE20%超になることを目指しており、この目標については変更していません。

最終利益の極大化のためには、成長分野で競争力を高め、売上高を増加することが最も重要です。あわせて、グループ内での効率化を推進し、徹底したコスト管理に努めることに加え、不採算事業からの撤退も視野に入れた経営が重要だと考えています。

株主還元については、ROE を達成することを目的とした自社株買い等は想定していませんが、ブイ・テクノロジーの稼ぐ力と株式市場の評価としての株価を見据えた上で、機動的に判断していきたいと考えています。

私からは以上になります。ありがとうございました。

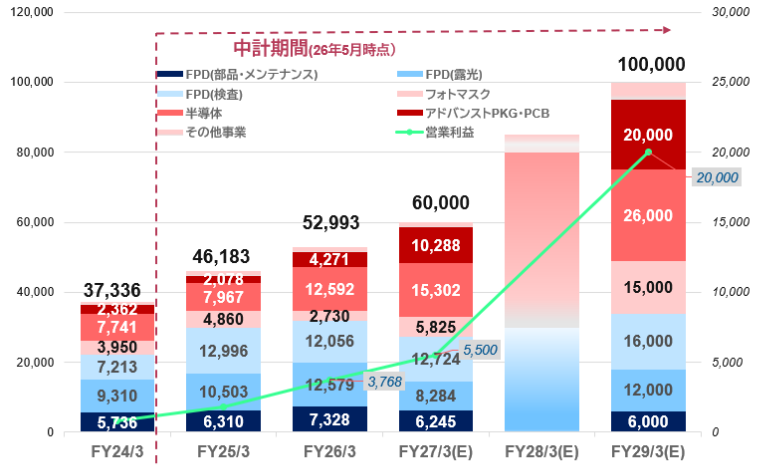
小野：神澤専務、ありがとうございました。続いて、社長の杉本より成長戦略についてお話しします。杉本社長、よろしくお願いします。

杉本：杉本でございます。ただいま専務の神澤から説明がありましたように、2026 年 3 月期は大幅な増収増益を実現したものの、当初計画していた売上・利益・受注ともに達成することができなくて、皆様にはご心配をかけたことと存じます。

今日私からは、現状を踏まえ中計を、2029 年 3 月期を全く数字をいじってないところの内容の説明ができればいいかなと思っています。

成長戦略：中期経営計画達成に向けて

2029年3月期の全社目標は維持（セグメント構成は変わる可能性）
達成に向け受注獲得に引き続き邁進

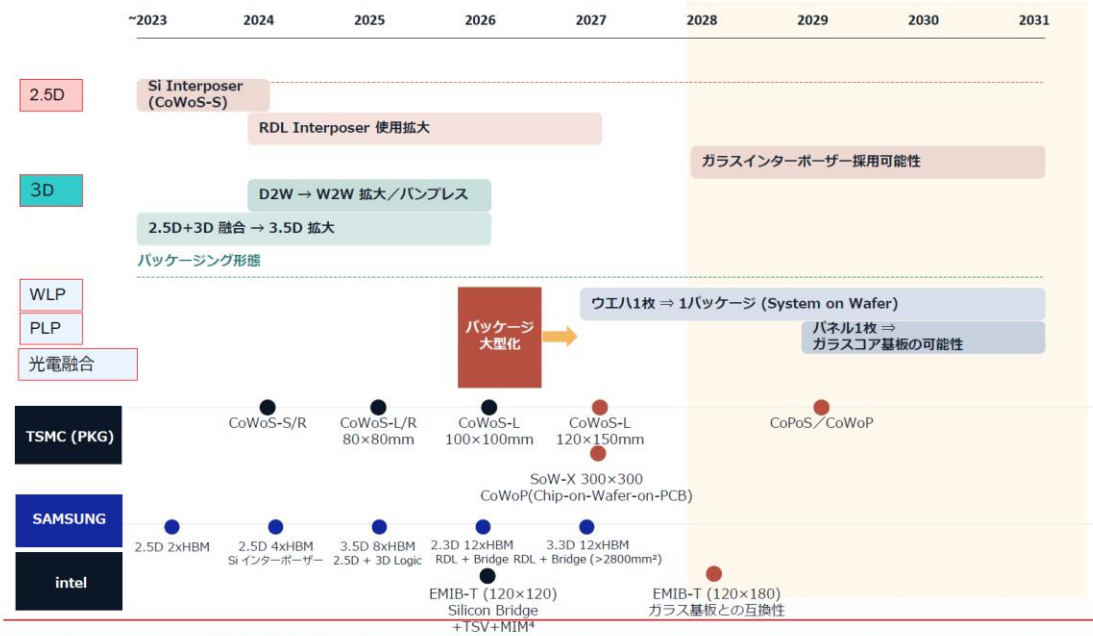


セグメント		狙う市場	主力製品
半導体フォトマスク	アドバンストパッケージ・PCB	・半導体パッケージ基板 ・汎用PCB基板	DI露光、O/Sテスター
	半導体	・シリコンウェハ ・フォトレジスト、他	・検査 ・マスクレス露光 ・コーデベ、他
	フォトマスク	・レガシー半導体 ・FPD	検査、修正、測定、他
FPD	検査	LCD、OLED、他	検査、修正、測定、他
	露光	LCD、他	ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ露光 光配向露光、他
	部品・メンテナンス	LCD、OLED、他	納入済製品のサービス

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.
17

基本的に、ここで 27 年 3 月期を若干の下方修正という形になりましたが、29 年 3 月期の売上高 1,000 億の営業利益 200 億というものは変更していませんので、引き続きこの目標に向かって全社を挙げてやっていく形になると思います。

AI半導体向け先端パッケージング技術のロードマップ



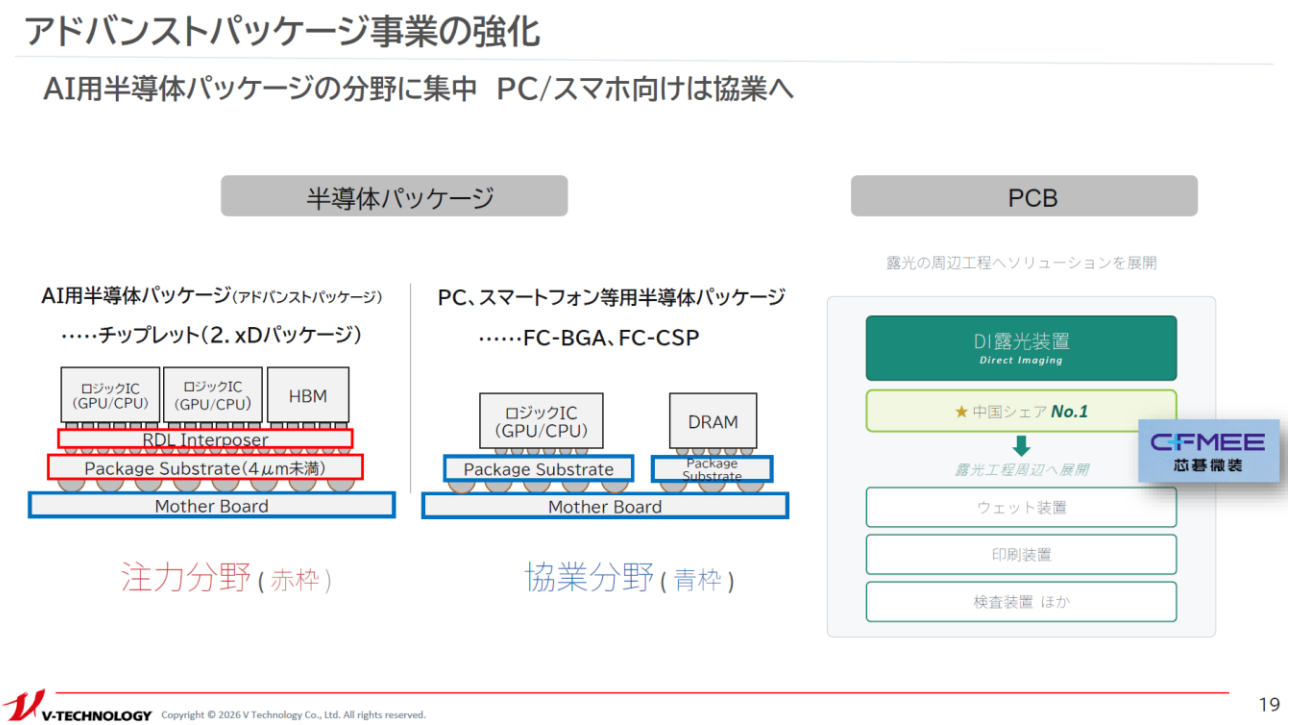
V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.
18

その 1,000 億を目指した中で、それぞれの私どもが手を入れている分野は成長していくと思われますが、最も成長が期待されるのが、この AI 半導体向けの先端パッケージの技術になります。

このページに先端パッケージ技術のロードマップが控えており、2023 年、2024 年頃から、新しいパッケージ技術として TSMC さんが発表された CoWoS や、しばらくしてから発表されたインテルさんのシリコンブリッジを使った EMIB といった新しい概念のパッケージ技術が発生してきています。この中で、それぞれの技術がどのように進化していくかが最大のポイントです。

もう一つ、AI の半導体はどんどんサイズアップしているのですね。このサイズアップがキーワードになります。

例えば、CoWoS ではシリコンのインターポーザを使いますが、シリコンインターポーザでは 300 が限界だというところから考えると、サイズアップしなくてはならないのではないかというところで、昨年われわれも取り組みましたように、600 角まで大きなインターポーザといったものの開発に各社で今盛んにトライされているところです。



左側に、AI 用半導体パッケージの絵が書いてありますが、実はこれは今、この状態で生産されていますが、これはまだパッケージサブストレート、それから RDL インターポーザともに量産は全部ステッパーで作っています。

パッケージサブストレートのほうが比較的制度の荒いステッパー、オークさんやズースさんなど、そういったプリント基板から上がってきたステッパーが主流として生産に寄与されています。

それから、RDL のほうはまだほとんどがシリコンインターポーザですから、シリコンインターポーザとなりますと、キヤノンさんがやられている i 線のステッパー、こういったもので生産されているのが現実です。

サイズアップの話があるのが最も大きなポイントで、それぞれサブストレートも RDL のインターポーザも、ステッパーではサイズアップに対応できないよねと、コストが合わないねといったところから、ここに DI を採用していこうという動きがあります。

そして、私どもは 25 年、昨年度も既に RDL のインターポーザ向けの 1 ミクロンのレゾリューションのものも納品していますが、今年ついにサブストレートの量産は DI が始まります。DI 元年になります。

これまでの DI は、全て右側の PC のほうですね、こちらで使われていたわけで、パッケージにはほとんど使われてなかった、ここの分野の成長がすさまじく大きいので、ここのパッケージサブストレートをとにかくどこが最初にわれわれが受注できるかといったところでした。

私どもは非常にいい状態に今あり、パッケージサブストレートについては、おそらく今年が元年になり、28 年に向かい大幅に私どもの DI が採用されていく、ここの部分のステッパーは、非常にもう多分先祖返りしない状態になっていくと思っています。

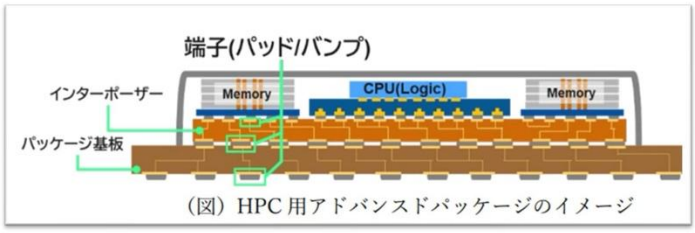
それから、RDL ですね、こちらは今メインが CoWoS でやられていますので、CoWoS の場合は、非常に今価格もいい商売をされていて、あまり無理した大サイズ化というコストのことを含めないで、300 ミリのウェハを 300 角でやろうかとか、そういった形の動きが進んでいます。

私どもは、長い目で見ると、必ず 600 角までくることを想定した製品開発に注力してまいりましたが、どうも踊り場の 600 角の前に 300 角のマーケットあるねということで開発して、今期から 300 ミリの RDL のインターポーザ向けの DI を出荷することになります。

これは、おそらく 2028 年に向けてそれぞれの会社さんで検討して、サブストレートが 26 年から、インターポーザが 28 年から、それぞれ DI が爆発的に伸びる、スタートすると考えています。

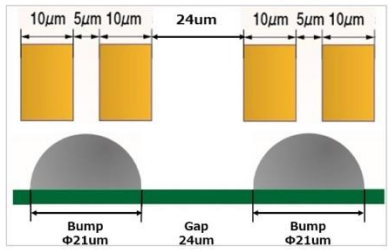
アドバンストパッケージ　テスター

テスター「LIBRA」



（図）HPC 用アドバンスドパッケージのイメージ

マイクロプローブ



2024年11月25日　PRニュースリリース　より

LIBRA は、従来方式の検査で対応が不可能なほどに狭ピッチ化が急速にすすむパッケージ基板・イ ンターポーザ（RDL）上の端子間の電気的な検査を、世界で初めて実現しました。この装置は、配線層を積層する途中工程から完成後の最終検査までに必要とされる多種多様な検査 に、当社グループの独自技術を結集して開発した超微細μプローブを採用、量産ラインへの適用が見込まれる 25μm ピッチ端子の4端子検査に業界で初めて対応しています。

V-TECHNOLOGY

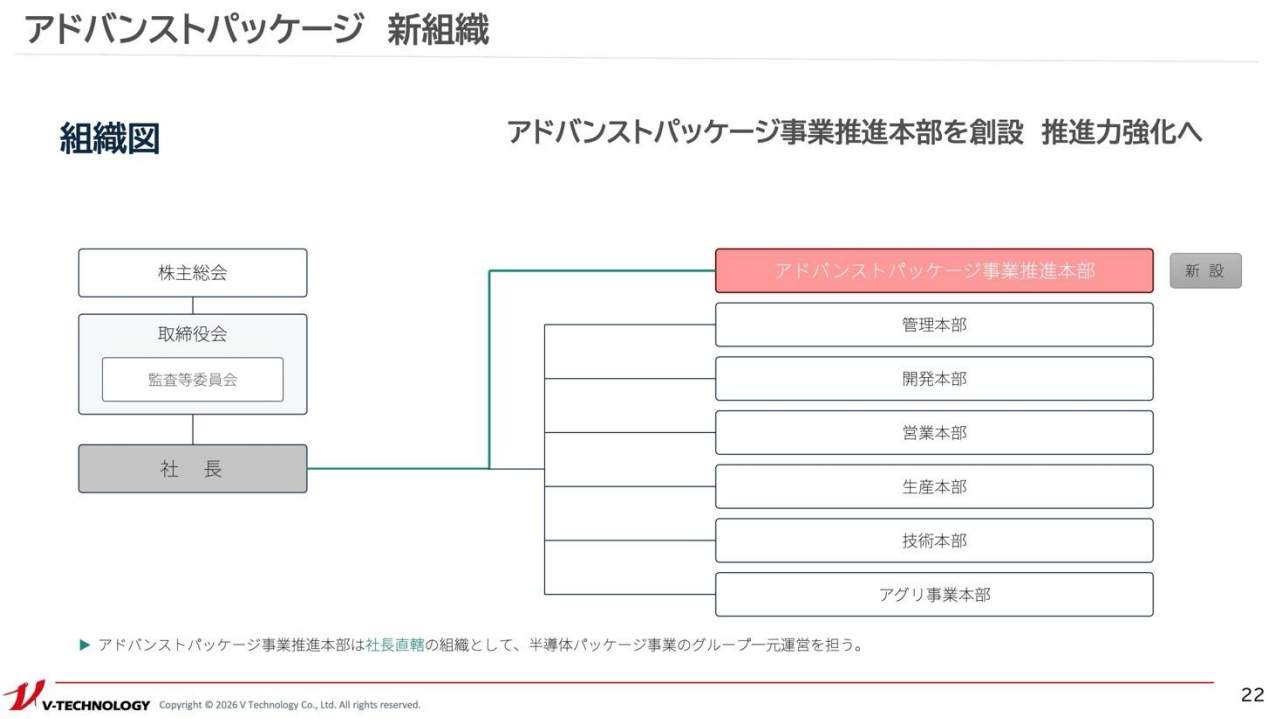
また、V テクグループでは、DI だけではなく、先ほどのパッケージ基板、サブストレート、さらにインターポーザ、これを全部半導体からつながっていくわけなのですよね。ですから、つながっていくところのパターンが本当に正確にできているか、これが大変重要になります。

残念ながら、今パッケージ基板ですら、バンプのピッチがだんだん細かくなり、EMIB だと今 47 ミクロンなのですね、さらに次世代の EMIB-T になりますと、25 ミクロンのピッチになります。

25 ミクロンのピッチに針を当てて電気検査するのは非常に難しいということから、当社が開発したマイクロプローブがこれに大変寄与できると考えています。

われわれのグループ会社であるオー・エイチ・ティーという会社からこの LIBRA というもの、これでテスター、導通確認と、その導通確認に利用、使用するマイクロプローブを V テクグループでも作っています。この辺の採用が大幅に伸びていくと。

ですから、先ほど僕が言った DI が、サブストレート 2026 年からと、2028 年からインターポーザ向けと言ったのが、全く同じ状況でこの LIBRA というテスターも伸びていくと考えています。



それで、V テクとしては、V テクの本体と、先ほどの DI 露光は子会社である LE-TECHNOLOGY、それからテスターはこれまた同じ 100%子会社のオー・エイチ・ティーというところでやっています。

それぞれの子会社がやっているものを、V テクのグループの中枢にそれをマネジメントする組織を作ろうと、アドバンストパッケージ事業推進本部を創設し、この推進力をグループ全体として強くしていこうと考えています。

DI露光装置「LAMBDI」をNEDOから受注

アドバンストパッケージ向け ― 世界初の解像度を達成

L/S = 0.5 μm

DI露光装置 LAMBDI Neo01

DI露光装置「LAMBDI」をNEDOから受注

～アドバンストパッケージ向けで世界初となるL/S＝0.5μmクラスを受注～

株式会社ブイ・テクノロジー（神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパーク イーストタワー9F、代表取締役 杉本 重人、以下「当社」）の連結子会社株式会社LE-TECHNOLOGY（東京都千代田区四番町4-19 CIRCLES市ヶ谷2F、代表取締役社長 李 椋、以下「LET」）は、インターポーザーおよびパッケージ基板向けDI（Direct Imaging）露光装置「LAMBDI（ラムディ）」において世界初となるL/S = 0.5μmクラスの開発に成功、この度、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）から、大阪公立大学を通じて受注いたしました。

当社グループは、2025年8月に1μm配線対応のDI露光機の出荷を開始しましたが、さらなる高解像度化を実現、今回の受注に至りました。今後も半導体および電子デバイスの進化を支える革新的な技術の創出に取り組み、社会の発展に貢献してまいります。

2026年4月7日ニュースリリース

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

また、どこまでパターンの細かさが進むかですが、これは既に NEDO、日本の NEDO のグループから次世代の DI 露光装置、これは 0.5 ミクロン、まだ世界どこにも出していませんが、0.5 ミクロンの LAMBDI、ラムディですね、LAMBDI を NEDO から受注しました。

これも今期の納品となりますので、V テクグループとしては、パッケージの形態、それから解像度、それから大きさ、それぞれに対応できるべく、グループ全体でしっかり管理していく形になります。

V テクの当社の評価、東証における評価は、もちろんこれまでのディスプレイ一本やりから半導体の方に力を入れ始めていますが、まだまだ成長の途中であると認識しています。

ですので、例えば売上の CAGR や EBIT のマージンなど、そういった部分は半導体で活躍されている会社さんに比べるとまだまだ見劣りしていると思っていますが、こちらの半導体の装置をやられている会社さんをベンチマークしながら、こういった会社さんに仲間入りさせてもらえるように努力していこうと考えています。

また、FPD に関して私から 11 月に、昨年のですね、インドのお話をしていますが、インドのプロジェクトはなかなか一筋縄でいかなくて、まだ決定がされておらず、ディレイしています。

私どもとすると、FPD のマーケット、中国マーケット、ある程度急成長はないもののステーブルに進んでいくと思っていますが、ここでもしインドのマーケットがスタートされると、私どもの活躍する場はまた大きく広がると考えています。

なお、インドプロジェクトについては、私どもの中計には今含んでおりませんので、それが入り始めると、また別の成長要因ができると考えています。その辺は、私どもとしても期待しているわけです。以上です。

小野：杉本社長、ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。